

2013年3月期 決算説明会

東京エレクトロン デバイス株式会社

2013年4月30日

決算報告

代表取締役副社長

久我 宣之

2013年3月期 業績予想下方修正

(百万円)

	年初 発表 (A)	2012.09.24 発表 (B)	2013.01.29 発表 (C)	年初発表予想との比較			
				増減 (A) - (B)		増減 (A) - (C)	
売上高	98,000	89,000	83,000	▲ 9,000	▲ 9.2%	▲ 15,000	▲ 15.3%
経常利益	2,700	1,550	1,150	▲ 1,150	▲ 42.6%	▲ 1,550	▲ 57.4%
当期純利益	1,650	920	550	▲ 730	▲ 44.2%	▲ 1,100	▲ 66.7%

2013年1月29日

半導体及び電子デバイス事業における民生機器向け・産業機器向け製品の需要低迷、コンピュータシステム関連事業におけるIT投資の一服感により、業績予想を下方修正

2013年3月期 業績予想と実績

(百万円)

	2013年3月期 実績	2013.01.29予想	
		予想額	達成率
売上高	85,477	83,000	103.0%
経常利益	1,292	1,150	112.4%
当期純利益	658	550	119.8%

2013年1月29日発表の業績予想に対する達成率は、売上高で103.0%、当期純利益で119.8%

業績 前期比較

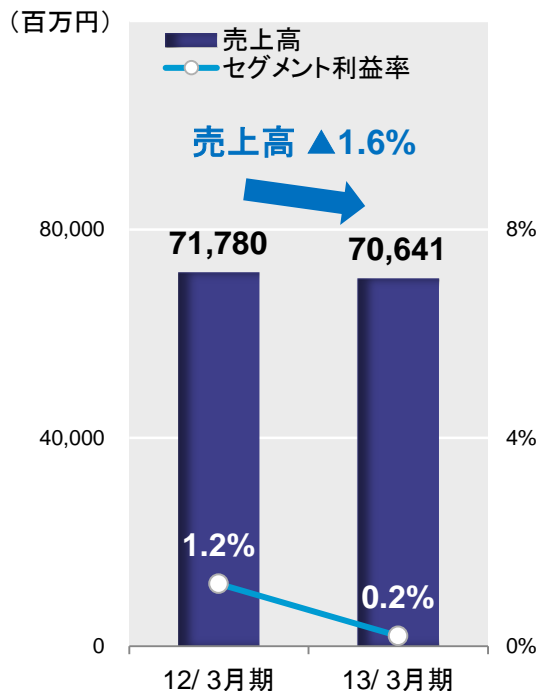
(百万円)

	2012年3月期	2013年3月期	対前年比	
			増減額	増減率
売上高	86,300	85,477	▲ 822	▲ 1.0%
EC事業	71,780	70,641	▲ 1,138	▲ 1.6%
CN事業	14,519	14,835	316	2.2%
売上総利益	15,354 (17.8%)	15,241 (17.8%)	▲ 112	▲ 0.7%
営業利益	2,011 (2.3%)	1,790 (2.1%)	▲ 221	▲ 11.0%
経常利益	2,332 (2.7%)	1,292 (1.5%)	▲ 1,040	▲ 44.6%
当期純利益	960 (1.1%)	658 (0.8%)	▲ 302	▲ 31.5%
従業員数	900名	948名	-	-

※EC事業:半導体及び電子デバイス事業、CN事業:コンピュータシステム関連事業
 ※()内は利益率

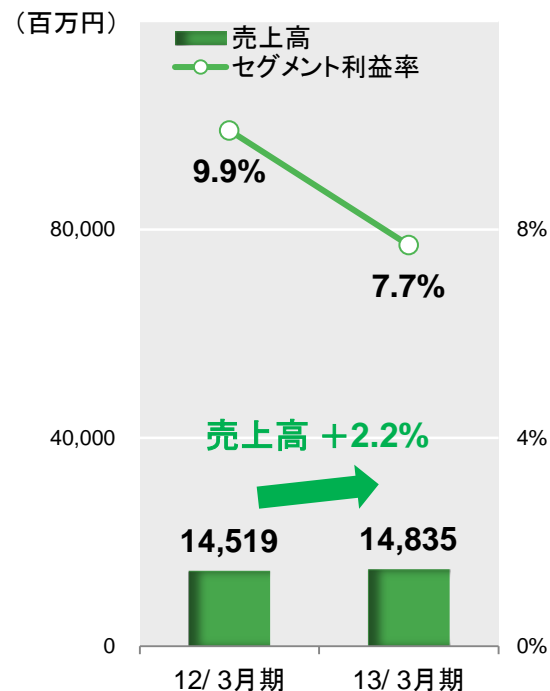
セグメント別 売上高・利益

➤ 半導体及び電子デバイス事業



海外事業伸長、国内は減少
商権拡大に伴う人員の増加とのれん等あり経費増

➤ コンピュータシステム関連事業



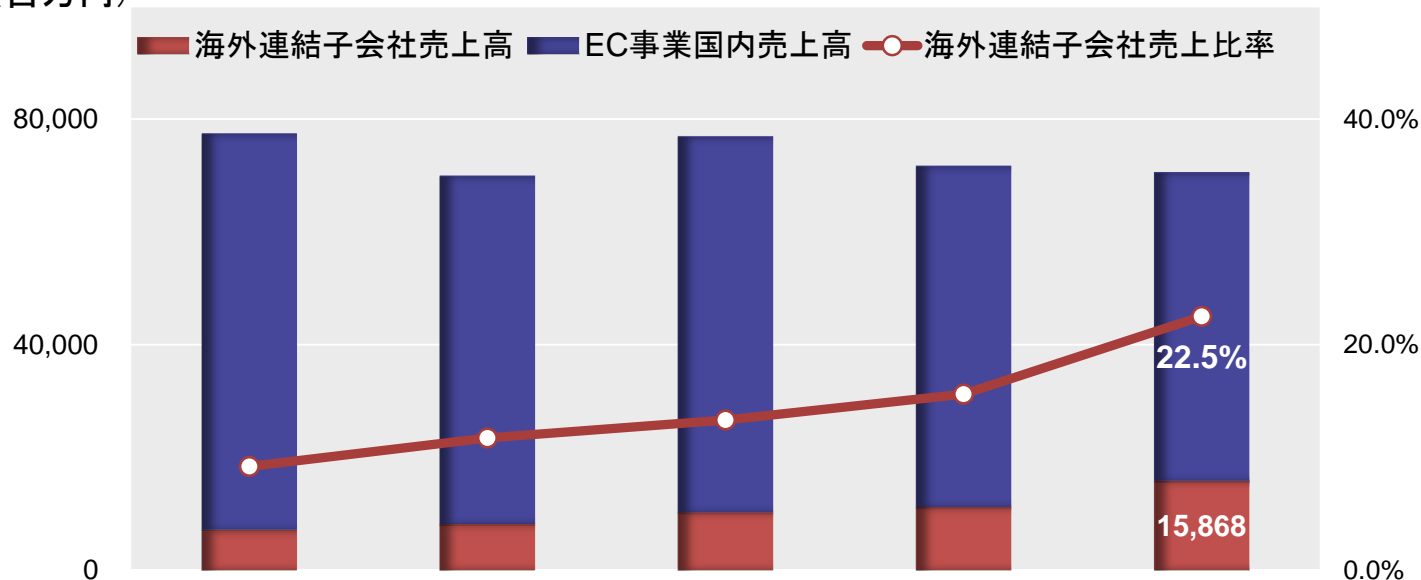
機器販売、保守ともに堅調
利益は前期計上の償却債権取立益の反動減

※取引形態の類似性を踏まえ「コンピュータシステム関連事業」が取り扱っていた組み込み機器向けソフトウェア等を「半導体及び電子デバイス事業」に移管しております。

※セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の経常利益と一致しております。

海外連結子会社売上高

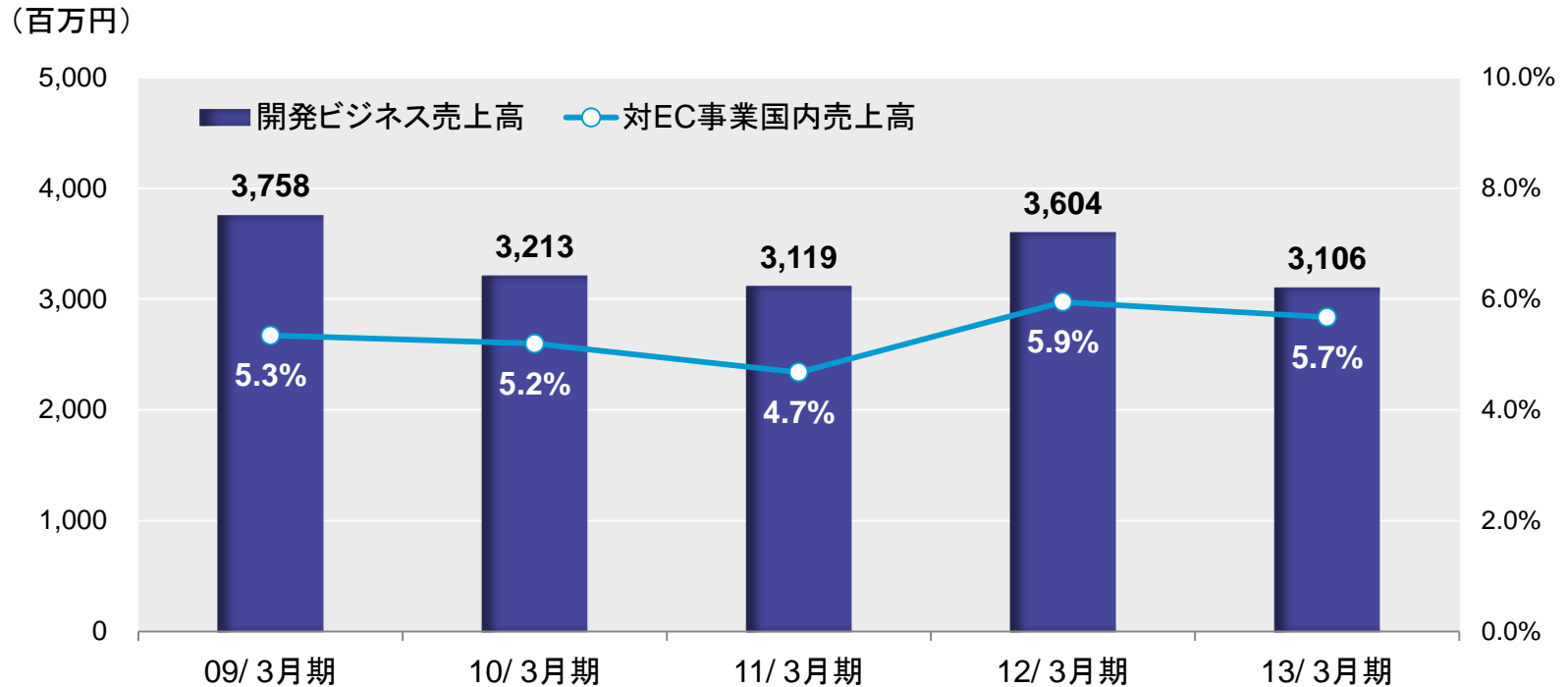
(百万円)



	09/3月期	10/3月期	11/3月期	12/3月期	13/3月期
EC事業セグメント売上高	77,504	70,023	76,967	71,780	70,641
海外連結子会社売上高	7,159	8,186	10,265	11,172	15,868
海外連結子会社売上比率	9.2%	11.7%	13.3%	15.6%	22.5%
海外連結子会社売上高(M\$)	71	88	119	141	191
為替レート	100.7円/\$	92.9円/\$	85.7円/\$	79.1円/\$	82.9円/\$

※海外連結子会社売上比率は、EC事業セグメント売上高に対する海外連結子会社売上高の割合

開発ビジネス売上高

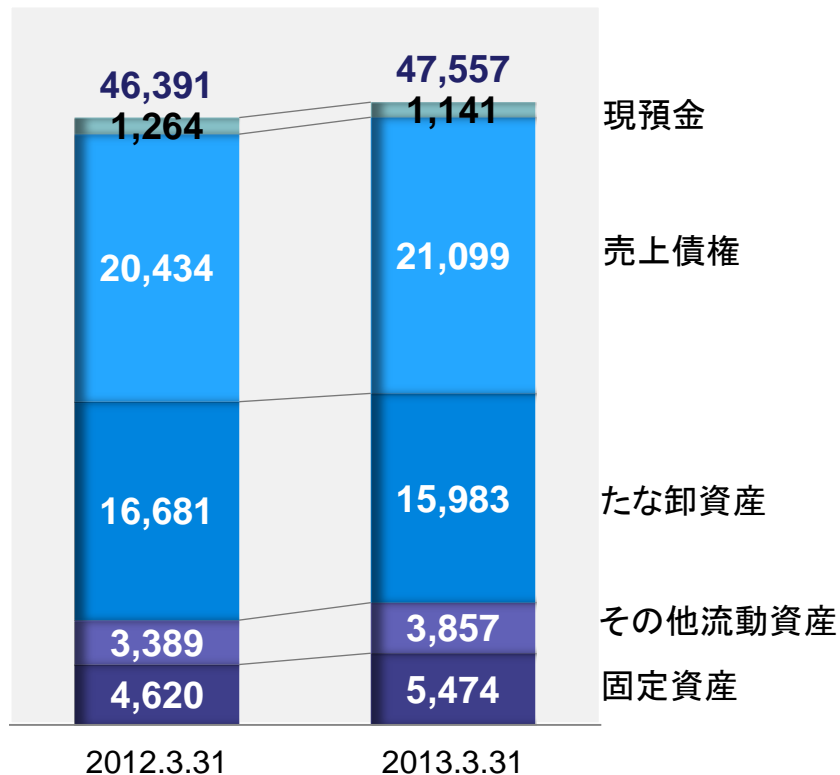


民生電子機器や産業機器の需要低迷を受け売上減少

貸借対照表

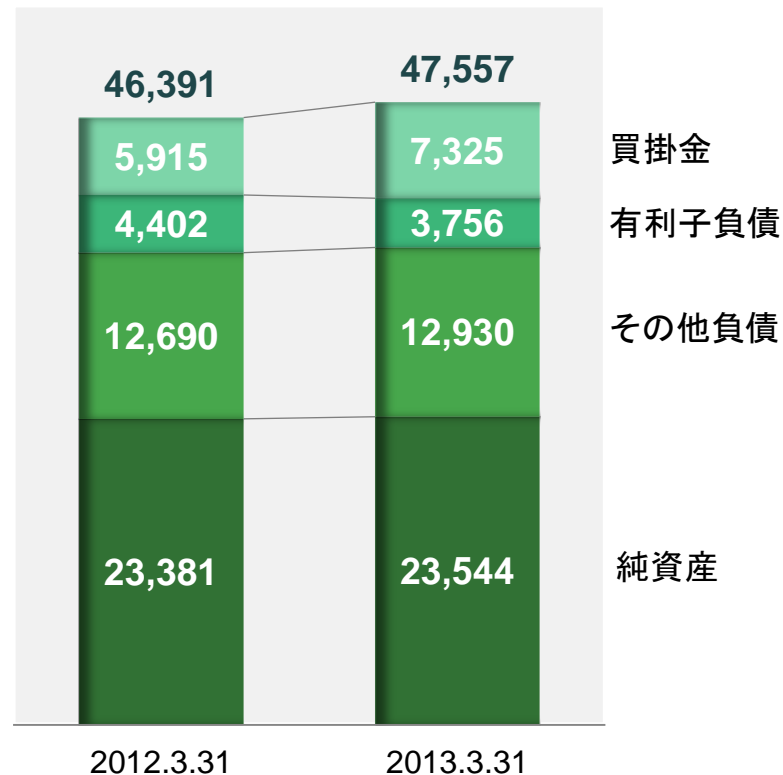
➤ 資産

(百万円)



➤ 負債・純資産

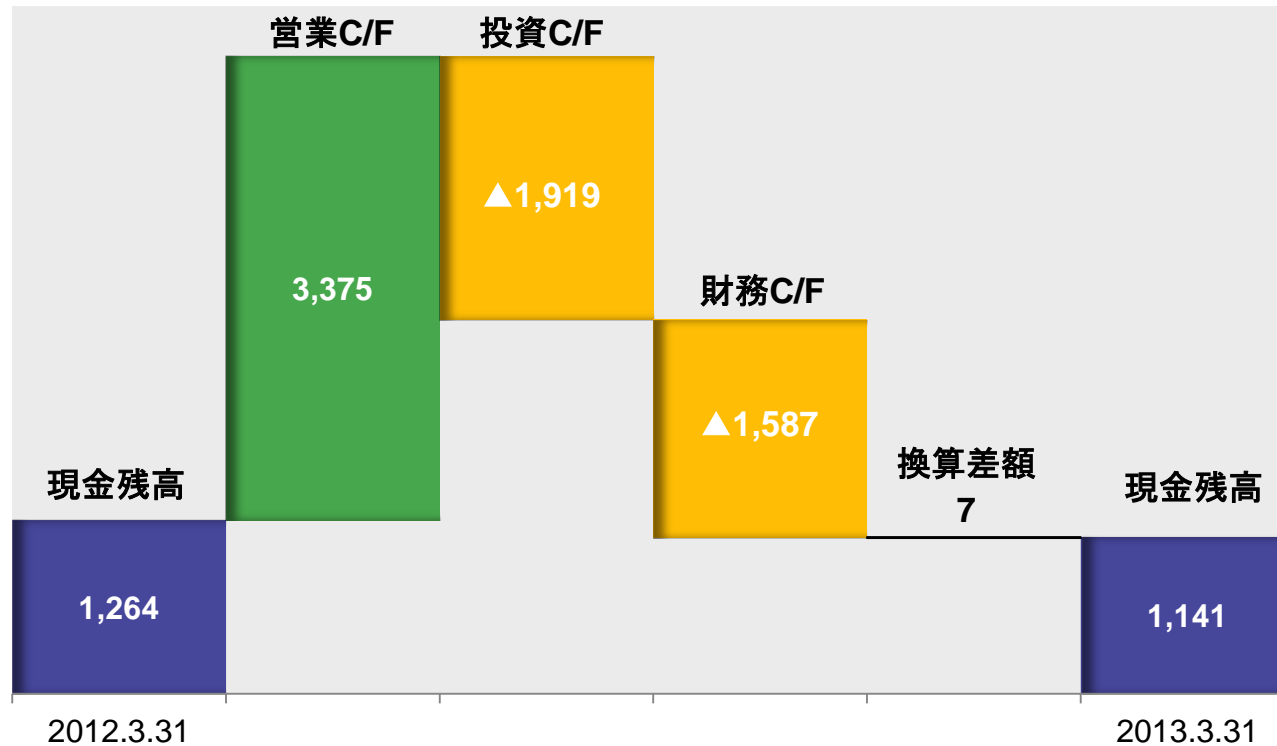
(百万円)



固定資産は、アムスク社からの商権移管に伴うのれんと新基幹システムの導入等により増加

キャッシュ・フロー

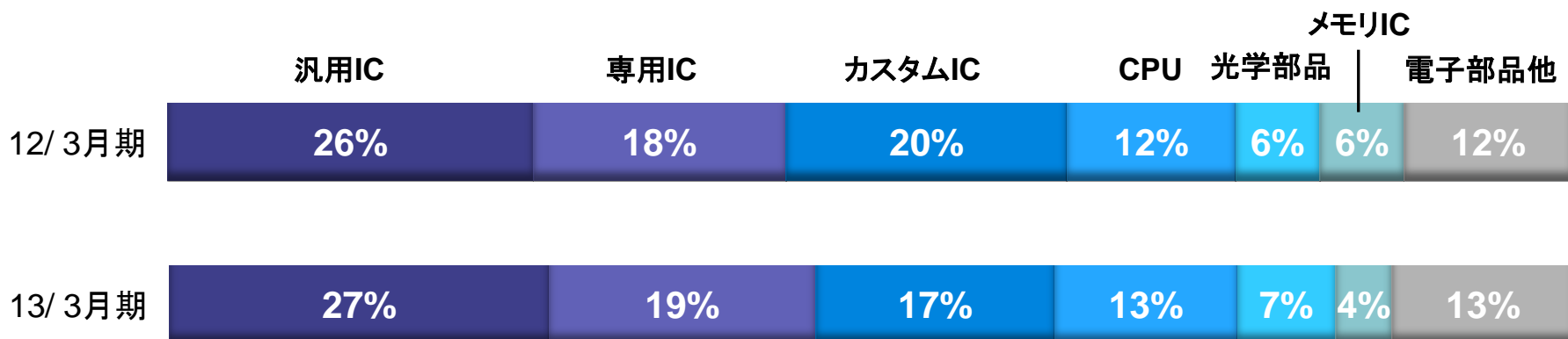
(百万円)



	2013年3月期	主な要因
営業C/F	3,375	たな卸資産の減少、仕入債務の増加
投資C/F	▲ 1,919	事業譲受、ソフトウェア(基幹システム)の取得、投資有価証券の取得
財務C/F	▲ 1,587	短期借入金の返済、配当金の支払い

セグメント情報 (EC事業)

➤ 品目別売上構成

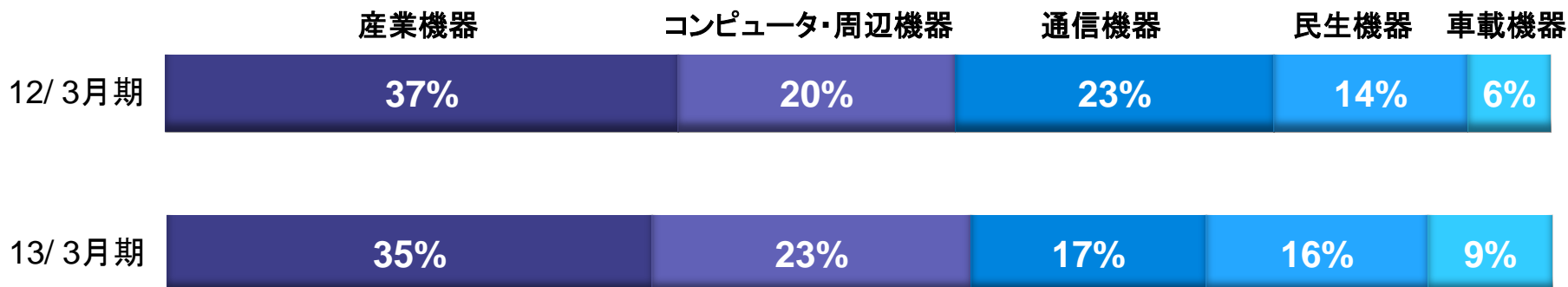


汎用IC(アナログ)、専用IC、CPU(DSP)は、商権拡大により増加
カスタムICは、産業機器向け販売低調により減少

* 詳細は、P.17をご参照ください。

セグメント情報 (EC事業)

➤ 用途別売上構成



産業機器の減少は、需要低迷が要因
コンピュータ・周辺機器は、商権拡大により増加
通信機器は、スマートフォン以外の機器において需要低調
車載機器は、マーケットが堅調であることに加え商権拡大により増加

* 詳細は、P.18をご参照ください。

セグメント情報 (CN事業)

➤ 品目別売上構成

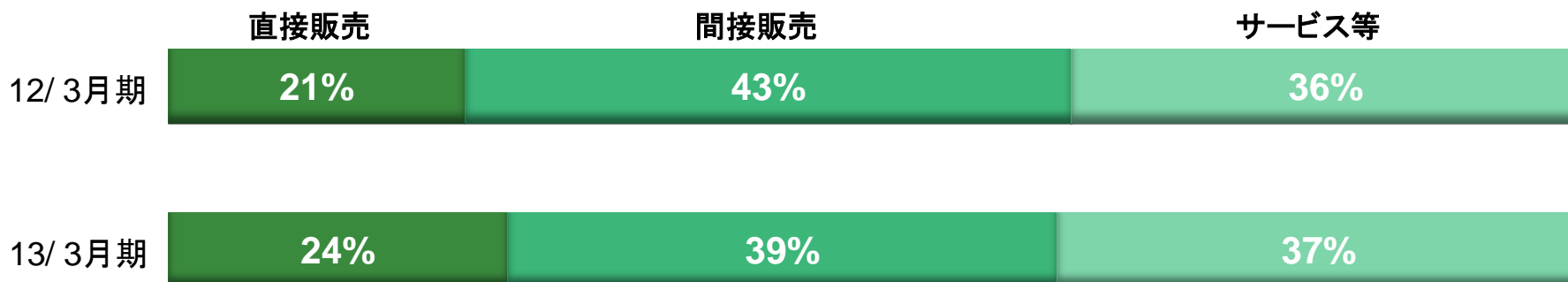


ネットワーク関連機器、ミドルウェア他は、強化している直接販売が奏功し増加、ストレージ関連機器は、国内企業向け低調

* 詳細は、P.19をご参照ください。

セグメント情報 (CN事業)

➤ 販売形態別売上構成



直接販売は、官公庁向け伸長
間接販売は、企業向け減少

* 詳細は、P.20をご参照ください。

補足資料

業績 半期推移

(百万円)

	2012年3月期		2013年3月期	
	上期	下期	上期	下期
売上高	41,787	44,512	42,866	42,611
EC事業	35,059	36,721	35,899	34,742
CN事業	6,728	7,791	6,966	7,868
売上総利益	7,322	8,031	7,286	7,955
営業利益	822	1,188	688	1,101
経常利益	1,263	1,069	686	606
当期純利益	699	261	406	252

セグメント別 売上高・利益・利益率

(百万円)

		2012年3月期	2013年3月期	
		実績	実績	構成比
セグメント売上高	EC事業	71,780	70,641	82.6%
	CN事業	14,519	14,835	17.4%
セグメント利益	EC事業	896	154	11.9%
	CN事業	1,436	1,138	88.1%
セグメント利益率	EC事業	1.2%	0.2%	-
	CN事業	9.9%	7.7%	-

※セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の経常利益と一致しております。

セグメント情報 (EC事業)

➤ 品目別売上増減

品目	対前年増減率	主な要因	主な仕入先
汎用IC	+ 3.7%	産業機器低調も商権拡大により増加	TI、リニアテクノロジー
専用IC	+ 5.3%	複合プリンタ、液晶プロジェクタ等PC周辺機器や民生機器が商権拡大により増加	TI、ピクセルワークス、ピクシス、インターシル、メモック、リアルテック、インビウム
カスタムIC	▲ 17.1%	産業機器減少、通信機器が商権喪失により減少	ザイリンクス、富士通
CPU	+ 8.3%	カーナビゲーションが商権拡大により増加	TI、フリースケール、インテル
光学部品	+ 0.9%	スマートフォン増加	アバゴ・テクノロジー
メモリIC	▲ 23.6%	通信機器が商権喪失により減少	IDT、スパンション
電子部品他	+ 0.9%	POS端末増加	マイクロソフト

※仕入先名は、略称で記載しております。

セグメント情報（EC事業）

➤ 用途別の傾向

用途	主なアプリケーション	当社の傾向
産業機器	医療機器、放送機器、テスター、ロボット、半導体製造装置、計測器、工作機械	全般的に低調
通信機器	携帯電話、スマートフォン、モバイル、ルーター、伝送装置、基地局	スマートフォン向け光学部品のみ堅調 それ以外の通信機器向けは低調
コンピュータ・周辺機器	複合プリンター、液晶プロジェクタ、PC及び付属機器	液晶プロジェクタ、複合プリンターが 商権拡大により大幅増加
民生機器	デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、TV、AV機器、家庭用ゲーム、リモコン	TV低調も 商権拡大により デジタルカメラ、家庭用ゲームは増加
車載機器	カーナビゲーション、カーオーディオ	カーナビゲーションが商権拡大により 大幅増加

セグメント情報 (CN事業)

➤ 品目別売上増減

品目	対前年増減率	主な要因	主な仕入先
ネットワーク 関連機器	+ 6.9%	官公庁向け製品販売伸長、 保守堅調	F5ネットワークス
ストレージ 関連機器	▲ 9.9%	企業向け販売低調	ブロード、EMC
ミドルウェア他	+ 31.2%	企業向けデータ分析ソフトウェア堅調	EMC、オラクル

※仕入先名は、略称で記載しております。

セグメント情報 (CN事業)

➤ 販売形態の傾向

用途	対前年増減率	当社の傾向
直接販売	+ 18.9%	官公庁向けネットワーク機器が伸長
間接販売	▲ 7.2%	国内企業の大型案件なく減少
サービス等	+ 3.6%	ネットワーク製品の販売伸長に伴い増加

従業員数

Technical Support
Development

➤ 連結従業員数

(名)

	2009年 3月期	2010年 3月期	2011年 3月期	2012年 3月期	2013年 3月期
国内	804	823	858	877	917
技術職	213	222	226	232	251
海外連結子会社	21	21	22	23	31
合計	825	844	880	900	948

主な経営指標

	2009年 3月期	2010年 3月期	2011年 3月期	2012年 3月期	2013年 3月期
売上高（百万円）	94,701	85,145	91,315	86,300	85,477
営業利益（百万円）	1,840	2,079	2,745	2,011	1,790
経常利益（百万円）	2,041	2,117	2,941	2,332	1,292
当期純利益（百万円）	617	1,166	1,918	960	658
純資産額（百万円）	21,413	21,911	23,220	23,381	23,544
総資産額（百万円）	40,680	45,649	50,254	46,391	47,557
1株当り純資産額（千円）	202	206	219	220	222
自己資本比率（%）	52.6	48.0	46.2	50.4	49.5
自己資本利益率（ROE:%）	2.9	5.4	8.5	4.1	2.8
株価収益率（PER:倍）	17.20	13.36	8.79	16.49	24.00

2014年3月期 活動方針と業績見込み

代表取締役社長

栗木 康幸

- ✓ 2013年3月期 取り組み
- ✓ 2014年3月期 活動方針と施策
- ✓ 2014年3月期 業績見込み
- ✓ 3ヶ年計画
- ✓ 配当について

2013年3月期 取り組み

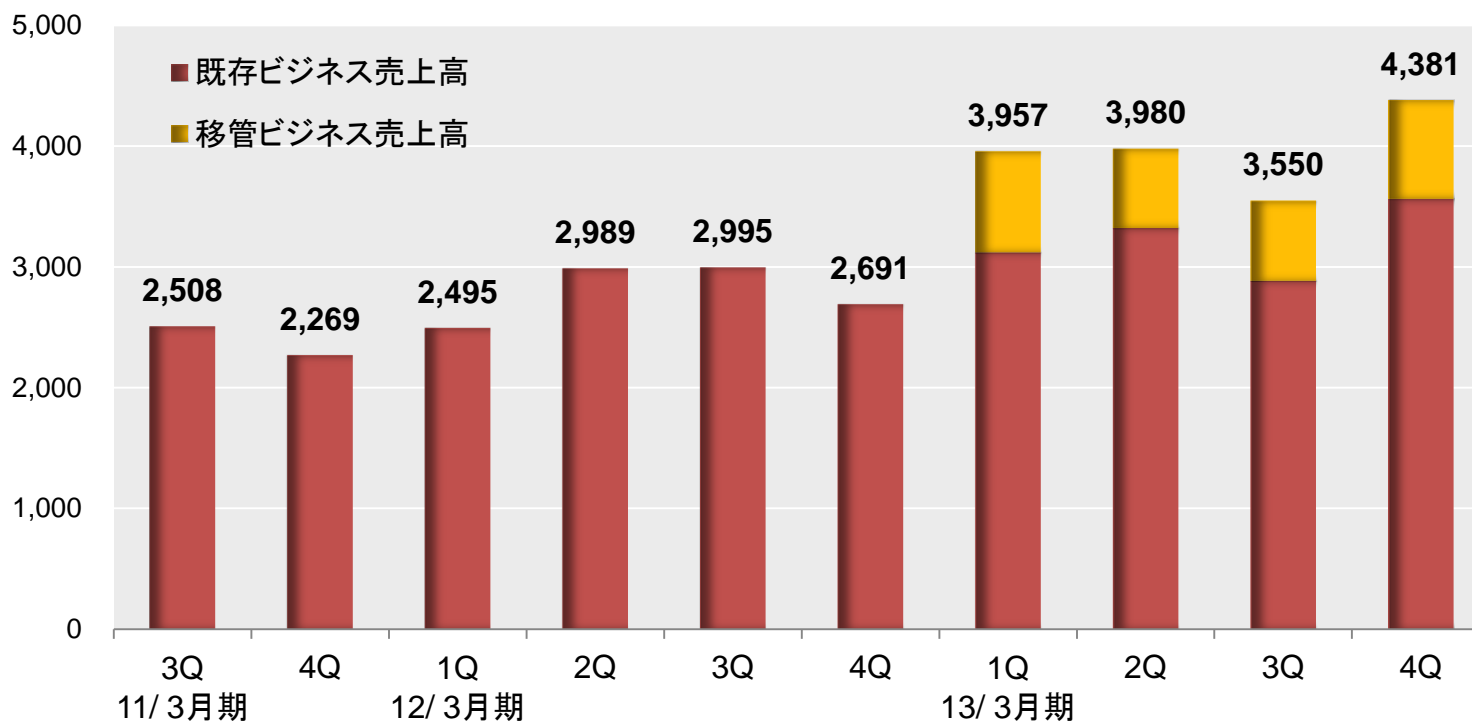
海外事業の拡大

➤ 海外拠点一覧

地域	拠点	
アジア	香港 中国(上海、大連、深圳、無錫) 韓国(ソウル) シンガポール マレーシア(クアラルンプール) 台湾(台北) タイ(バンコク)	2012年9月 2012年9月 2013年4月
アメリカ	アメリカ(フリーモント)	
ヨーロッパ	イギリス(ロンドン)	2012年7月

➤ 海外連結子会社 売上高の伸長

(百万円)



新商材の開拓

➤ 新規商材一覧 (EC事業)

取扱い開始	メーカー名	製品
2011年3月期	LYNK LABS社	特殊LEDモジュール
	IPS社	固体リチウムイオン電池
	Semikron社	パワー半導体
	Memsic社	MEMSセンサ
2012年3月期	Powercast社	環境発電デバイス(電波)
	Micropelt社	環境発電デバイス(温度差)
	Realtek社	ネットワーク向け専用IC
2013年3月期	Digi international社	M2M向けワイヤレスモジュール
	Cypress社	Psoc、USBコントローラ、SRAM
	Chilisin社	インダクター(巻線コイル)

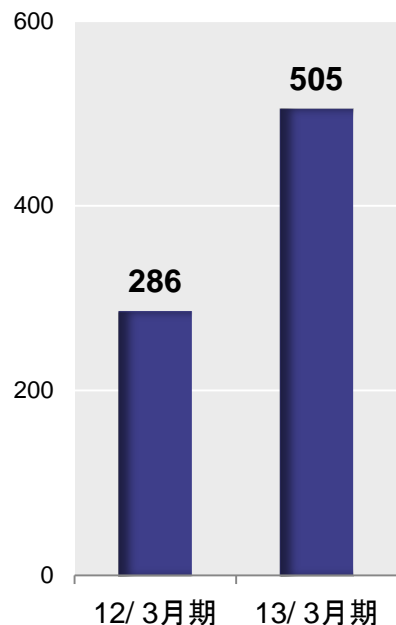
➤ 新規商材一覧 (CN事業)

取扱い開始	メーカー名	製品
2011年3月期	Fusion-io社	PCI Express フラッシュ SSDストレージ
2012年3月期	Nicira社	ネットワーク仮想化ソフトウェア
2013年3月期	Pure Storage社	オールフラッシュアレイ SSDストレージ
	Basho Technologies社	クラウドサービス構築用ストレージソフトウェア

➤ 新規商材売上状況

MEMSIC社

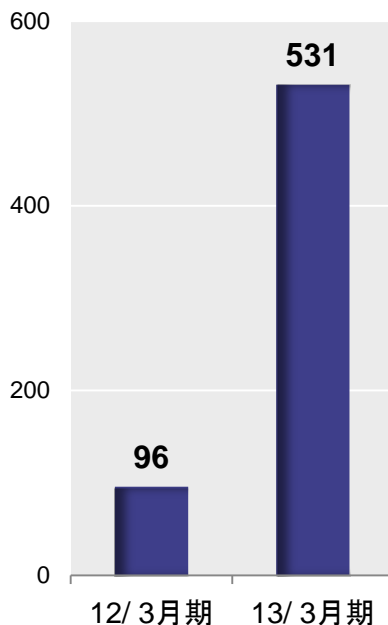
(百万円)



売上高前年比: + 76.5%

REALTEK社

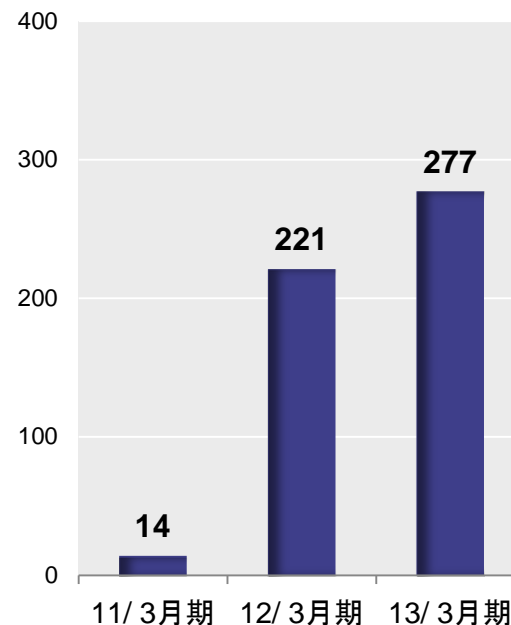
(百万円)



売上高前年比: + 455.9%

FUSION-IO社

(百万円)



売上高前年比: + 25.2%

2014年3月期 活動方針と施策

✓ 新規取り扱い商品の売上拡大

✓ 海外事業の拡大

✓ 新事業領域への挑戦

2014年3月期 施策 ～新規取り扱い商品の売上拡大～

➤ 新規取り扱い商品の対象市場

Digi international社



スマートグリッド、太陽光発電、
空調制御、監視システム等の
M2M市場

Cypress社



モバイル機器、データ通信、
車載、産業機器

Chilisin社



Total Solution Provider for EMI, Power and RF

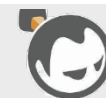
あらゆるアプリケーションに
対応可能

Pure Storage社



サーバー仮想化、仮想デスクトップ環境
を検討している企業

Basho Technologies社



basho

Webサービス、モバイルサービスを含め、
クラウドプラットフォームを手掛ける企業

2014年3月期 施策 ～海外事業の拡大～

➤ EC事業

製品の拡充

インレビウム製品の
海外展開加速

- ✓ 当社取り扱い商品と開発技術を融合したインレビウム製品の販売を強化
- ✓ 海外市場におけるマーケティングの強化とインレビウム製品開発

顧客の拡大

新規顧客の開拓

- ✓ 現在注力しているアジア地域に加え、欧米地域での日系顧客の開拓

設計開発力を生かした製品の拡充と顧客拡大により、一層の海外販売促進を図る

2014年3月期 施策 ～新事業領域への挑戦～

➤ EC事業

アジア地域でのマーケティング

韓国事務所・台湾事務所が
中心となり、
高機能パターン配線材
基板材などの新商材を発掘

世界への発信源に

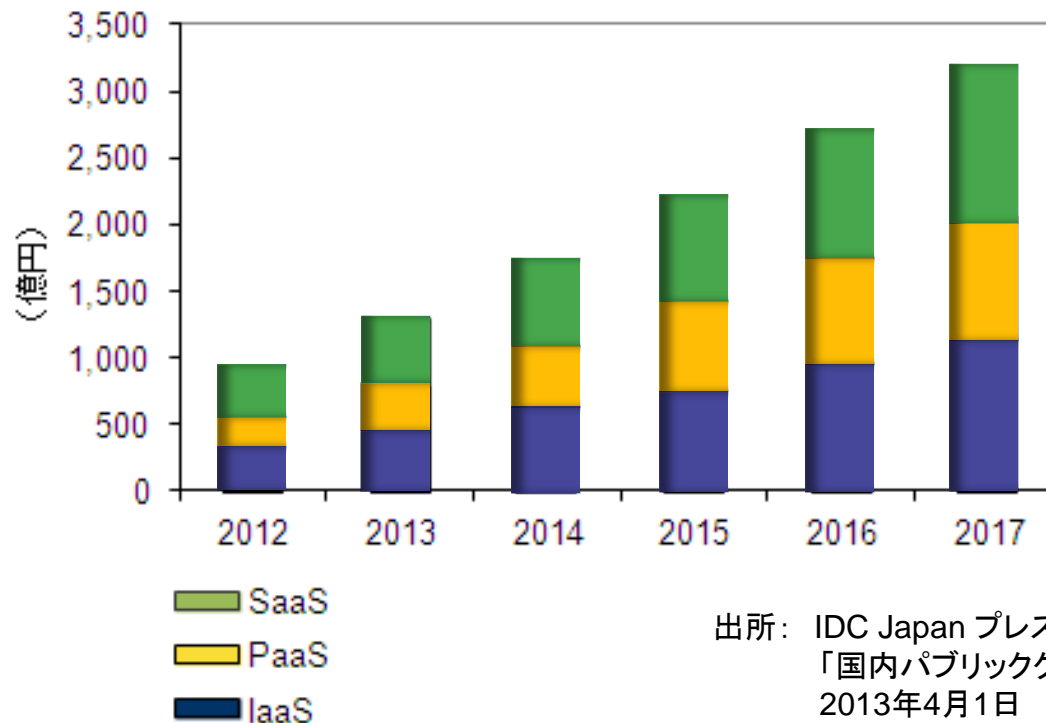
日本をはじめとする
アジア各国に加え、
欧米諸国も視野に入れた
販売

製品分野にとらわれず、アジア発の新規商材を世界に発信

2014年3月期 施策 ～新事業領域への挑戦～

➤ CN事業

国内パブリッククラウドサービス市場予測



2012年～2017年の年間平均成長率は27.8% (約3.4倍)

2014年3月期 施策 ～新事業領域への挑戦～

➤ CN事業

クラウド環境のテクノロジーを検討し、パブリッククラウド分野をターゲットにした通信キャリアやデータセンター向けのプロダクトの充実とアプローチを強化

Basho

分散型データストア

ソーシャル、モバイル、クラウド環境に適したスケーラビリティ、フォールトトレランス

PureStorage

オールフラッシュ・ストレージアレイ

データ圧縮と重複排除により実用量の5～6倍のデータが記録可能に。これによりHDDと同等の容量単価を実現

Arista

イーサネットスイッチ

データセンター(クラウド基盤、仮想化環境)に最適化

F5 Networks

ネットワーク関連製品

アプリケーション・デリバリー・コントローラ
ファイアウォール
SSL-VPNアプライアンス など

Brocade

ストレージ関連製品

スイッチ
コンバージド・ネットワーク・アダプター
ネットワーキング・プラットフォーム など

EMC

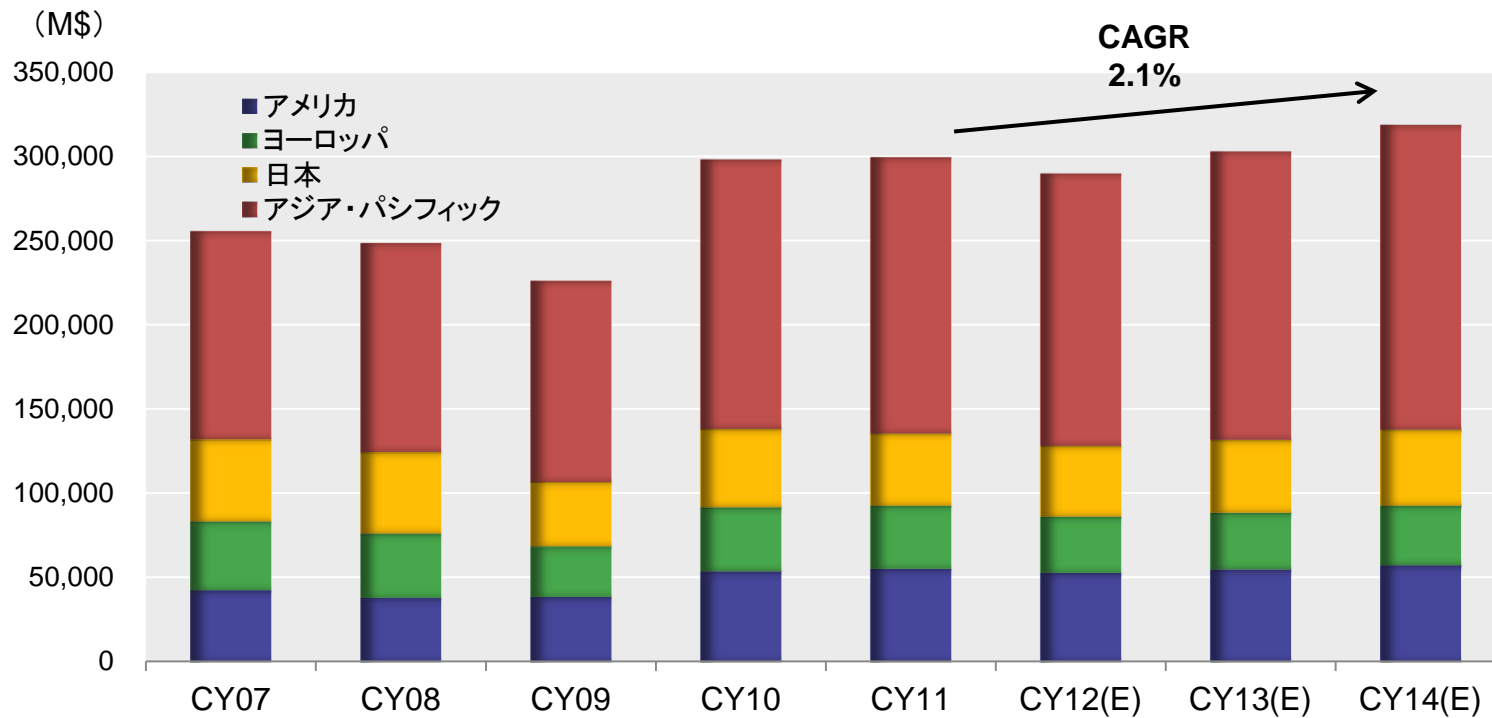
ストレージ関連 /ミドルウェア製品

ストレージ
バックアップ・システム
データベースエンジン など

さらに、データサービス等の新事業領域に挑戦する

2014年3月期 業績見込み

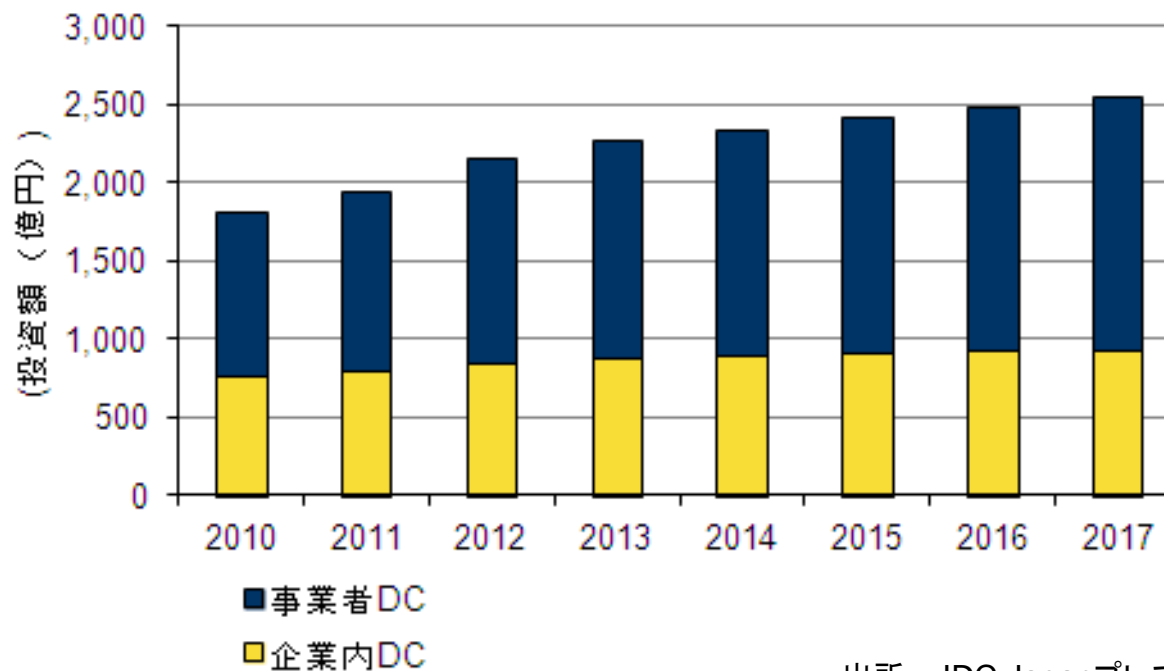
➤ 世界地域別半導体市場予測



出所: WSTS 2012年秋季半導体市場予測
「世界地域別市場予測」 2012年11月

アジア地域は拡大が見込まれる

➤ 国内データセンター新設投資予測



出所： IDC Japanプレスリリース
「国内データセンター新設投資予測を発表」
2013年4月16日

Note: 2012年までは実績値、2013年以降は予測

国内データセンターへの投資は、中長期的に堅調に推移すると予想する

▶ 半導体及び電子デバイス事業

国内半導体市場は、下期以降の復調を想定

アジア半導体市場は、成長持続を想定

商権拡大、新商材、海外事業等の伸長が、下期顕著になると想定

▶ コンピュータシステム関連事業

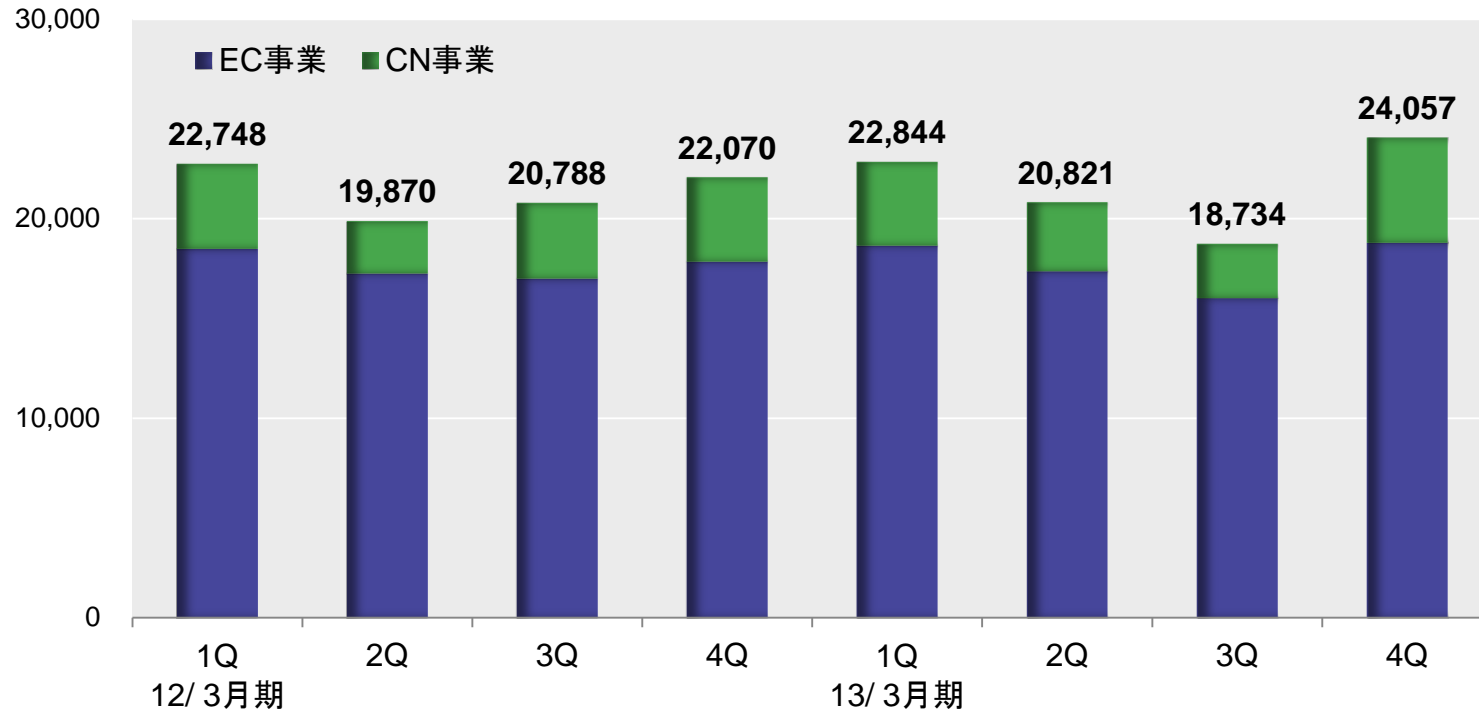
クラウド市場、データセンター市場は拡大を想定

パブリッククラウド市場向け製品やサービスに注力

企業の国内IT投資は、下期偏重傾向

受注高推移

(百万円)



EC事業は2013年3月期第4四半期より受注高回復傾向。
CN事業は通年でみるとコンスタントな推移。

2014年3月期 業績予想

(百万円)

	2013年3月期	2014年3月期			対前年比	
	実績	上期予想	下期予想	通期予想	増減額	増減率
売上高	85,477	42,500	47,500	90,000	4,522	5.3%
EC事業	70,641	36,000	39,000	75,000	4,358	6.2%
CN事業	14,835	6,500	8,500	15,000	164	1.1%
経常利益	1,292 (1.5%)	450 (1.1%)	1,050 (2.2%)	1,500 (1.7%)	207	16.0%
当期純利益	658 (0.8%)	280 (0.6%)	650 (1.3%)	930 (1.0%)	271	41.2%

※()内は利益率

3ヶ年計画

3ヶ年計画

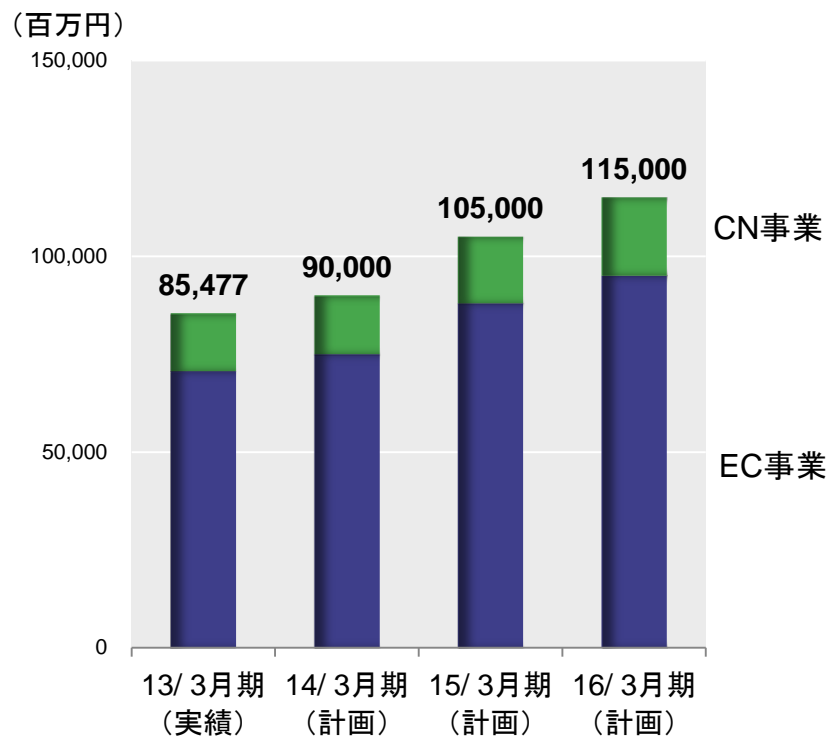
Technical Support
Development

(百万円)

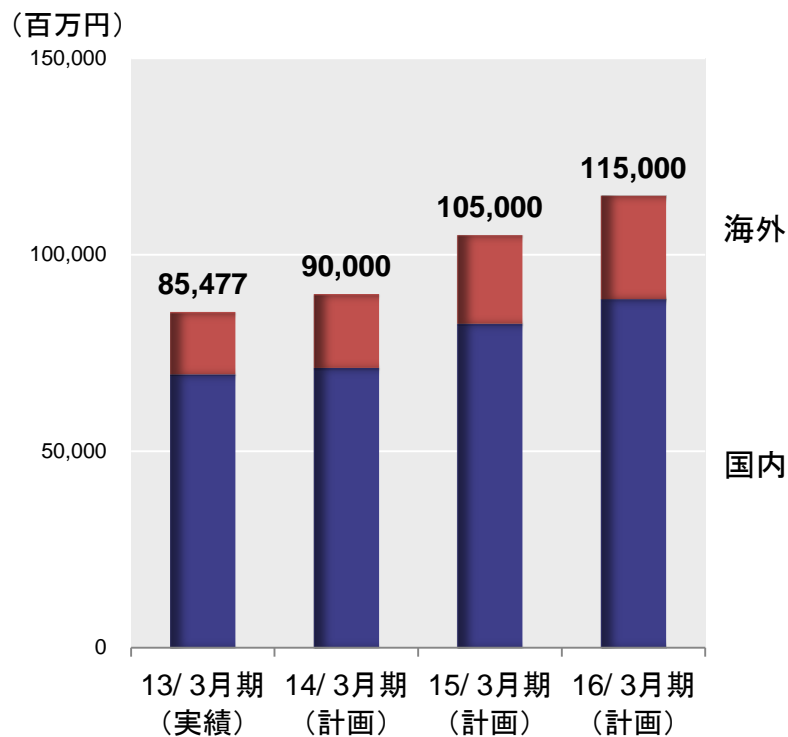
	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	2016年3月期
	実績	計画	計画	計画
売上高	85,477	90,000	105,000	115,000
EC事業	70,641	75,000	88,000	95,000
CN事業	14,835	15,000	17,000	20,000
経常利益	1,292	1,500	3,000	4,000
経常利益率	1.5%	1.7%	2.9%	3.5%

3ヶ年計画(内訳)

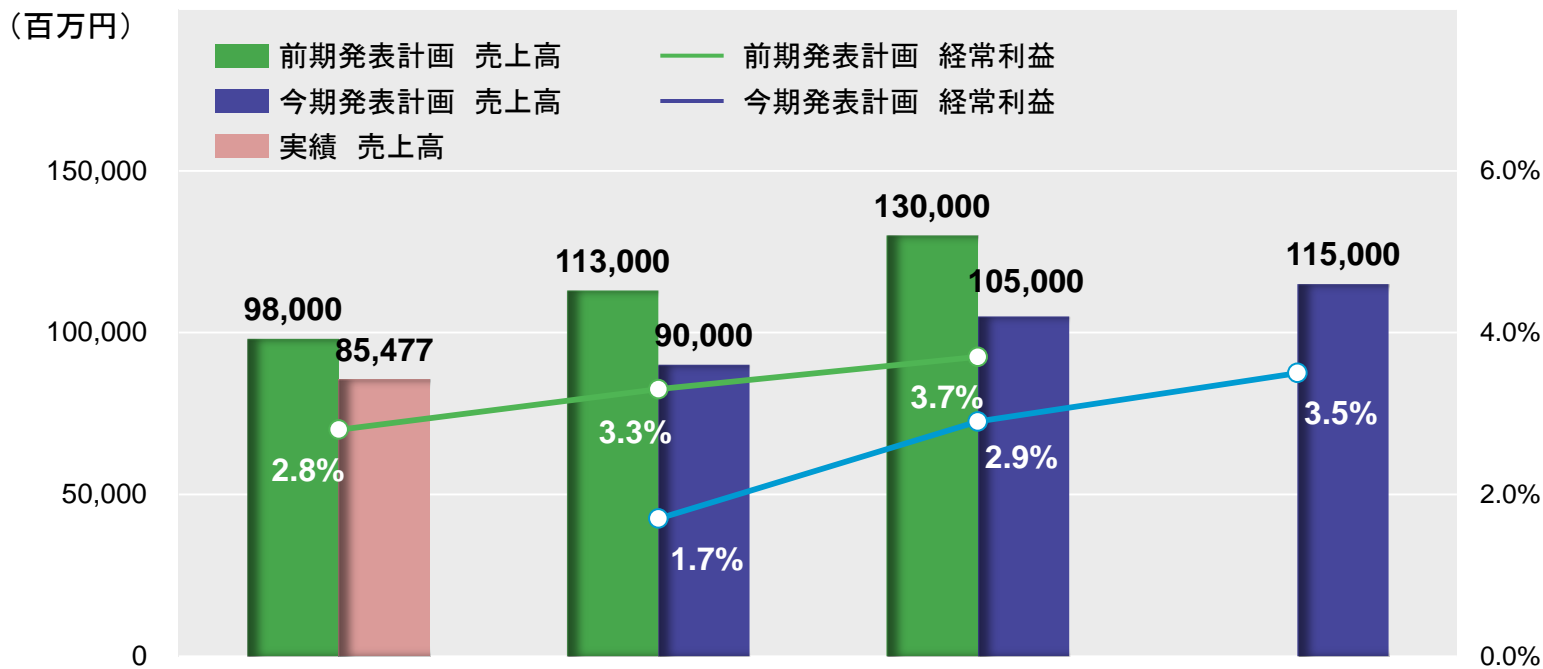
セグメント別 売上高構成比



地域別 売上高構成比

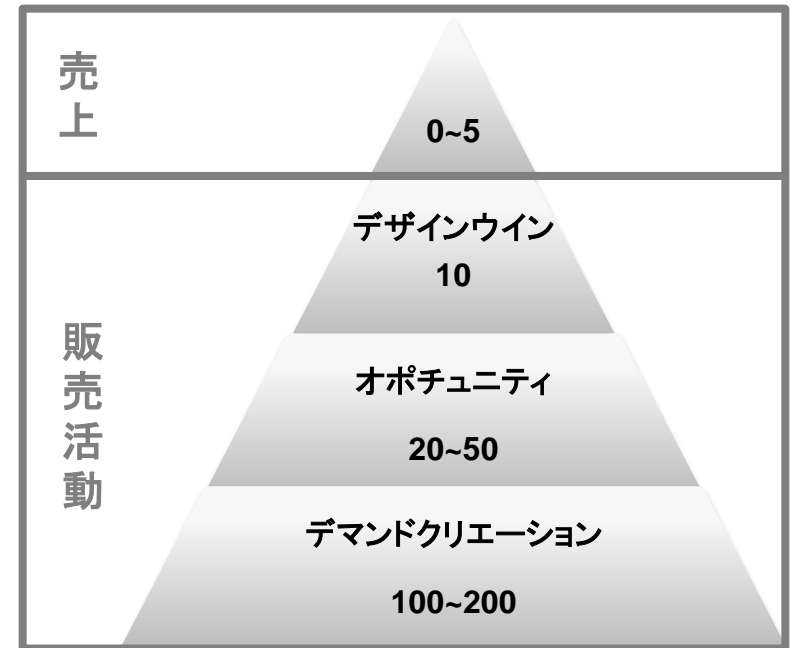
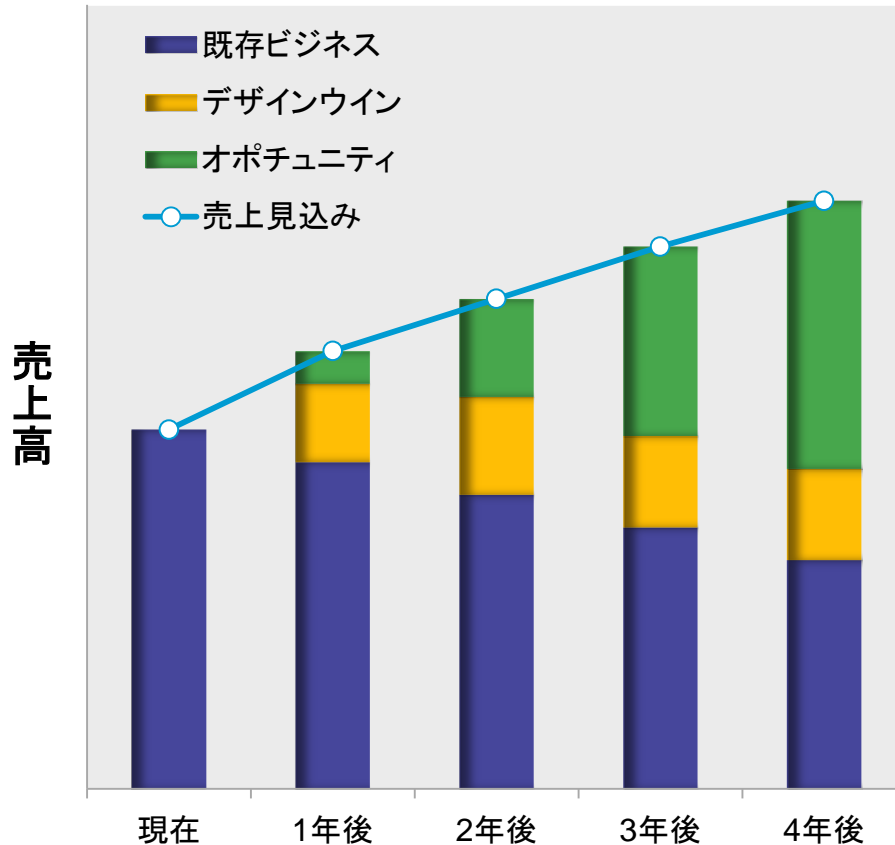


前期発表3ヶ年計画との比較



		13/ 3月期	14/ 3月期	15/ 3月期	16/ 3月期
実績	売上高	85,477	-	-	-
	経常利益率	-	-	-	-
前期発表	売上高	98,000	113,000	130,000	-
	経常利益率	2.8%	3.3%	3.7%	-
今期発表	売上高	-	90,000	105,000	115,000
	経常利益率	-	1.7%	2.9%	3.5%

売上計画策定の考え方 (EC事業)



顧客の開発計画段階から販売活動(オポチュニティの発掘・デザインウイン)を開始し、その活動に基づき売上計画策定を行う

配当について

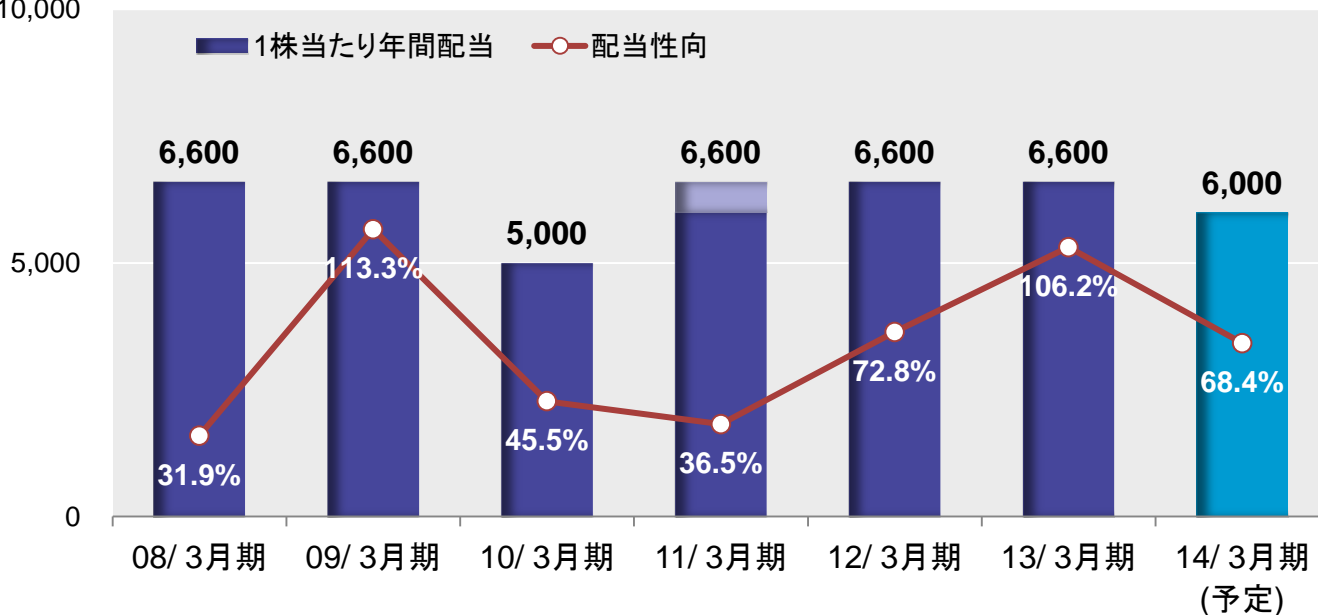
当期配当予想

➤ 配当ポリシー

継続的かつ安定的な配当の実施を基本として、業績を反映した適正な利益還元を原則。
当面の配当性向の水準については連結当期純利益の35%程度を目安。

➤ 1株当たり年間配当金

(円)
10,000



トピックス

レスキューロボットコンテスト

CSR活動の一環として「inrevium杯 第13回レスキューロボットコンテスト」へ特別協賛いたします



当社ではコンテストの審査員を務めるほかに、参加学生様をはじめとするご来場者の皆様に広く半導体技術を知っていただくためにインレビウム製品を中心とした当社取扱い製品の展示も行います。

レスキューロボットコンテストの理念：
「技術を学び 人と語らい 災害に強い世の中をつくる」

神戸予選 2013年6月30日(日)
東京予選 2013年7月 7日(日)
競技会本選 2013年8月10日(土)～11日(日)

今年は初めて関東にて競技会予選を実施。
参加校は前回より6チーム増え、
今年は26チームが技術やアイデアを発表します。



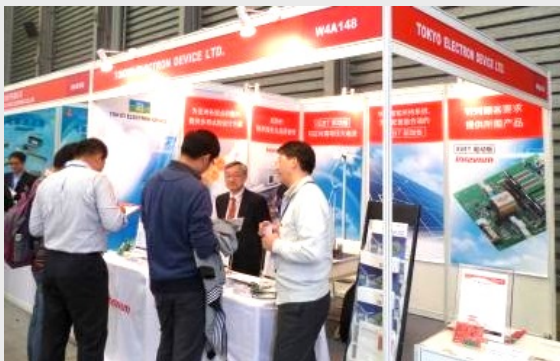
海外での展示会への参加

海外での現地顧客の開拓やインレビアム製品の認知度を高めるため、中国での展示会に出展

China International Industry Fair 2012

日程： 2012年11月6日～10日
会場： Shanghai New International Expo Centre
（上海）

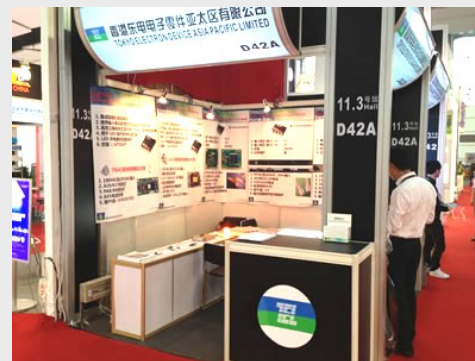
インレビアム事業部がEnergy Showに出展し、TED(inrevium)のIGBTゲートドライバソリューションを中心に展示。「IGBT」に対する来場者の関心が高く、高い品質を誇るinrevium製品群に注目が集まった。



LED CHINA 2013

日程： 2013年3月1日～4日
会場： China Import and Export Fair
Pazhou Complex Area B(広州)

TED APACがTI社のLEDドライバを使用したソリューションを中心に展示。商談やデモボード貸出やサンプルデバイスの依頼の対応を行った。



補足資料

品目 (EC事業)

品目	主な製品	機能
汎用IC	アナログIC、ロジックIC	色々な用途に共通に使用されるIC
専用IC	画像処理用IC、 通信用・ネットワーク用IC	特定用途用に作られた専用IC
カスタムIC	ASIC、PLD	お客様の仕様に応じて作られる固有IC
CPU	マイクロプロセッサ、DSP	電子機器の頭脳、演算機能・制御機能
光学部品	発光ダイオード、フォトカプラ	電気を光に変換して使用する電子部品
メモリIC	SRAM、FRAM、MRAM、 フラッシュメモリ	記憶用IC、書込み、読出しが可能なものや読出しのみのもがある
電子部品他	ソフトウェア、ボード、電源、 コネクタ	企業向け産業機器に組み込まれるソフトウェア。 プリント配線基板上にIC、電源、コネクタなどの部品を 実装した製品 (ボード)

品目 (CN事業)

品目	主な製品
ネットワーク関連機器	インターネット接続機器(負荷分散、セキュリティ) 企業向けネットワークシステム構築機器
ストレージ関連機器	SAN(ストレージエリアネットワーク)スイッチ、 SAN接続機器、ストレージセキュリティ機器など
ミドルウェア他	データウェアハウス用データベースソフトウェア 組み込みデータベース

仕入先

Technical Support

セグメント	品目	主な仕入先
EC事業	汎用IC	リアテクノロジー社、TI社
	専用IC	コネクサントシステムズ社、IDT社、インターシル社、メモシク社、ピクセルワークス社、リアルテック・セミコンダクター社、シリコンイメージ社、TI社、ピクシシステムズ社、インビーム
	カスタムIC	富士通セミコンダクター(株)、ザイリンクス社、インビーム
	CPU	フリースケール・セミコンダクタ社、富士通セミコンダクター(株)、インテル社、TI社
	光学部品	アバゴ・テクノロジー社
	メモリIC	IDT社、スパンション社
	電子部品他	コーセル(株)、マイクロソフト社、インビーム
CN事業	ネットワーク関連機器	エクストリームネットワークス社、F5ネットワークス社
	ストレージ関連機器	ブロード社、EMC社(アイシロン、データメイン)
	ミドルウェア他	EMC社(グリーンプラム)、オラクル社

このプレゼンテーションで述べられている将来の当社事業に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。

当社の参画するエレクトロニクス業界及びIT業界は変化のスピードが大変速く、また、世界経済、半導体市況など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがって、今後当社の業績見通しが本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含みおきください。
また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。